

# ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

・ビア 3 と配線層 2 との間の界面に配線 1 を保護する保護剤 6 を斑状に分散配置する。そして、保護剤 6 が存在しない界面領域 7 それぞれの大きさを、ビア 3 を構成する導電粉 4 の複数が配線層 2 に当接可能な大きさに設定する。これにより、導電粉 4 の複数と配線層 2 とを、保護剤 6 が存在しない界面領域 7 それぞれにおいて互いに当接させて電氣的に接続し、これによって接続抵抗を長期的に安定化させる。